

※鉚釘接點選用參考：

不同額定電流的開關，尺寸、材質的使用，因各種開關機構設計不同與接點材料的進步，很難訂出標準公式，此為多年試驗的經驗數據。

額定電流 (Rated current)	一般開關用(溫升較低) General Switch Application (Lower Temperature Rising)		耐熔著開關用(溫升較高) High Anti-welding Switch (Higher Temperature Rising)	
	交流 AC	直流 DC	交流 AC	直流 DC
10A 以下 (10A or less)	Ag-1	Ag-1	B-12 N-10	N-10 U-25
10A ~20A	B-12 N-10 L-10	N-10 U-25 L-10	B-16 E-10	B-16 L-10 E-10
20A 以上 (20A or more)	B-16 E-10	E-10 B-16	X-2 焊接鉚釘 (Brazed Rivet)	F-11 焊接鉚釘 (Brazed Rivet)

※鉚釘接點設計參考：

1.頭型(F 平面或 R 弧面)：

一般固定接點用 F 型，可動接點用 R 型。有些特殊設計開關，可動固定接點均有 S 斜紋溝，使碳渣落於溝內，可降低開關溫升。

2.頭徑(D)：

2.1 頭徑(D)尺寸：

2.1.1 頭徑(D)尺寸儘量取 0.5mm 之倍數進位，如 $\phi 1.5$, $\phi 2.0$... $\phi 6.0$ 等。

2.1.2 頭徑(D) ≤ 2.4 mm 時，用單層鉚釘為宜。(D) > 6.5mm 須大電流試驗者，建議用焊接型鉚釘。

2.1.3 頭徑(D)最大範圍可為足徑(d)之 1.7 ~ 2.3 倍。

2.2 頭徑(D)公差：

一般為 ± 0.1 mm。但頭徑小於 2.4mm 則可加嚴為 ± 0.075 mm。

3.頭厚(T)：

3.1 頭厚(T)尺寸：

3.1.1 一般鉚釘接點之頭厚(T)，單層鉚釘以 0.5mm 以上，雙層鉚釘以 0.7mm 以上為佳。如開關之空間容許時，T 可稍厚，使散熱面積增大，而降低溫昇。

3.1.2 特殊尺寸之頭厚(T)，可在頭徑(D)尺寸的 20% ~ 40% 之間，如 D=3mm，則 T=0.6 ~ 1.2mm。

3.2 頭厚(T)之公差：

一般開關頭厚(T)之公差為 $\pm 0.05\text{mm}$ ，但頭徑(D)大於 6.0mm 之接點，公差放寬至 $\pm 0.1\text{mm}$ 。接點鉚合時，頭厚會因鉚合擠壓而稍為變薄，且接點經使用消耗後，間隙加大，因此設計時宜取上限值。

4.足徑(d)：

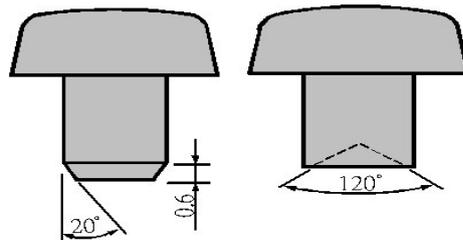
4.1 足徑(d)尺寸：

4.1.1 雙層鉚釘：足徑(d)尺寸，務必設計為標準足徑 0.5mm 之整數倍數進位，如 $\phi 1.5$ 、 $\phi 2.0$ 、 $\phi 2.5$ 、 $\phi 3.0$ 等。

4.1.2 單層鉚釘：與上列雙層鉚釘相同，如頭徑(D)小於 2.0mm,常用足徑可為 $\phi 0.8$ 、 $\phi 1.0$ 及 $\phi 1.2$ 。

4.1.3 斜足：如果「銅片孔徑」與「接點足徑(d)」設計配合良好建議不用斜足。(斜足如下圖左)

4.1.4 中空足：常用「圓錐形」中空足的角度為 120° ，最小不宜小於 90° (如下圖右)。



4.2 足徑(d)公差：

4.2.1 上限+0、下限 - 0.1mm，以免銅片之鉚合孔沖成下限的情況下，鉚釘無法放入銅片中。

4.2.2 銅片之鉚合孔應比鉚釘之足徑(d)大 0.05 ~ 0.10mm 左右 (視鉚釘大小)。

5.足長(L)：

5.1 足長(L)尺寸：

一般鉚釘接點之足長(L)，要比欲鉚之銅片的厚度多 0.8 ~ 1.5mm 以上 (視鉚合孔之公差)，再進位為 0.5mm 之倍數。

5.2 足長(L)公差：

一般為+0.15/ - 0mm 或 $\pm 0.1\text{mm}$ 。